

## EMW3010 Wi-Fi 物联网模组

数据手册

内置华为海思 Hi3861 Wi-Fi Soc, 接入华为物联网平台专用  
2.4G Hz IEEE 802.11 b/g/n, 超高集成度, 丰富的外设

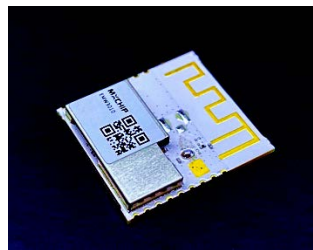
版本: 1.4

日期: 2021-08-25

编号: DS0160CN

## 概 要

- 电压输入: 3.0V~3.6V
- 工作环境温度: -40°C to +85°C
- 处理器: Hi3861(L)处理器, 主频高达 160MHz
- 存储器
  - 352K 字节的 SRAM
  - 288K 字节的 ROM
  - 2M 字节的 XIP Flash
- Wi-Fi
  - IEEE 802.11 b/g/n 1T1R 2.4GHz 单频 (ch1 ~ ch14)
  - 支持 HT20, 72.2Mbps@MCS7
  - 支持 WPA/WPA2 PSK, Open/WEP/TKIP/CCMP,
  - 支持 WPS 2.0
  - 支持 IEEE Power Save 节能模式
  - 支持 RF 自校准方案
  - 支持 STA 和 AP 形态, 作为 AP 时最大支持 6 个 STA
- 功耗
  - Ultra Deep Sleep 模式: 5μA@3.3V
  - 内置 Hi3861 处理器**
    - DTIM1: 1.5mA@3.3V
    - DTIM3: 0.8mA@3.3V
  - 内置 Hi3861L 处理器**
    - DTIM1: 0.9mA@3.3V
    - DTIM3: 0.4mA@3.3V
    - DTIM10: 250uA@3.3V
- 接入丰富的外设
  - 13 x GPIO
  - 7 x ADC 通道
  - 3 x UART, 支持硬件流控制
  - 1 x SPI, 1 x I2S
  - 2 x I2C
  - 1 x SDIO
  - 6 x PWM



## 接口和尺寸

- 保持与同类封装模组的引脚兼容性
- 邮票孔或插针
- 适用于照明应用的白色 PCB 油墨
- 板载 PCB 天线, 18 mm x 20 mm

## ● 丰富的配套软件

- 支持 LiteOS 操作系统
- 支持 HarmonyOS 操作系统
- 提供 Hilink 云平台接入 SDK

## ● 典型应用

- 智能家电
- 智能电工产品
- 工业自动化

## ● 订货代号

订货代号	说明
EMW3010-PZI6	板载 PCB 天线, Hi3861 处理器
EMW3010-PI6A	板载 PCB 天线, Hi3861L 超低功耗处理器
EMW3010-EZI6	外接天线 IPEX 座, Hi3861 处理器
EMW3010-PZI6-TR	板载 PCB 天线, Hi3861 处理器, 卷带包装

## 系列订货代码

例如	EMW	3	01	0	-P	ZI	6	A	-xxx
产品系列									
EMW = 物联网 Wi-Fi 模组									
产品类型									
3 = 焊接类无线模组									
典型目标应用和功能									
01 = IOT 物联网应用 1 系列									
外形尺寸, 增强功能									
0 = 2 x 9 pins 1.5 间距 邮票孔									
射频接口									
P = 18 mm x 20 mm, 2.4GHz 板载 PCB 天线									
Z = 18 mm x 20 mm, 2.4GHz 外置天线 IPEX 接口									
PSRAM 容量(可选)									
Z=不含 PSRAM									
J=4M 字节的 PSRAM									
温度范围									
6 = 工业级温度范围, -40°C~85°C									
可选项									
A = 使用超低功耗处理器 Hi3861L (默认使用 Hi3861)									
可选项									
TR = 卷带包装 (默认使用托盘)									

如需了解所有相关特性清单 (如包装, 最小订单量等) 和其他方面的信息, 请联系就近 MXCHIP 销售点和代理商。

## 配件

订货代号	说明
MXKIT-Base	开发板主板, 适用于所有 EMW3010 模组
MXKIT-Core-C3010	适用于 EMW3010 的开发板核心板, 包含 EMW3010-P 模组。和 MXKIT-Base 配套使用
FX-3010	EMW3010 生产治具, 内含陪测板: MXKIT-Base, MXKIT-Core-3010

## 版本更新说明

日期	版本	更新内容
2020-05-18	0.1	初版
2020-06-11	0.2	添加射频参数, 总装尺寸图, 封装图
2020-07-18	0.3	更新简介, 引脚说明, 模组实物图
2020-09-09	0.4	更新订货代码信息
2020-10-14	1.0	增加订货代码, 更新电气参数
2020-10-28	1.1	更新引脚定义说明, 增加模组侧视尺寸图
2020-11-10	1.2	删除工作模式部分内容
2020-12-17	1.3	增加低功耗信息
2021-08-25	1.4	更新封装尺寸图

## 版权声明

未经许可, 禁止使用或复制本手册中的全部或任何一部分内容, 这尤其适用于商标、机型命名、零件号和图。

## 目录

1. 模组简介.....	1
2. 引脚定义.....	2
2.1. 引脚分布.....	2
2.2. 引脚定义.....	2
3. 电气参数.....	4
3.1. 绝对最大参数.....	4
3.2. 工作电压和电流.....	4
3.3. 典型应用功耗.....	4
3.4. 温度.....	5
3.5. 静电放电.....	5
3.6. 射频参数.....	5
3.6.1. Wi-Fi 射频参数.....	5
4. 天线信息.....	7
4.1. PCB 天线参数和使用.....	7
4.1.1. 板载 PCB 天线参数.....	7
4.1.2. PCB 天线使用要点.....	7
4.2. 外接天线参数和使用.....	7
4.2.1. SRRRC 认证特别声明.....	8
5. 总装尺寸和 PCB 封装.....	9
5.1. 总装尺寸图.....	9
5.2. 推荐封装图.....	9
6. 生产指南.....	10
6.1. 注意事项.....	11
6.2. 二次回流温度曲线.....	11
7. 标签信息.....	12
8. 存储条件.....	13
附录 1. 销售与技术支持信息.....	14

## 表目录

表 1 引脚定义.....	2
表 2 工作模式选择.....	3
表 3 绝对最大参数：电压.....	4
表 4 工作参数：额定电压和电流.....	4
表 5 典型应用功耗 (HI3861H).....	4
表 6 典型应用功耗 (HI3861L).....	4
表 7 温湿度参数.....	5
表 8 静电释放参数.....	5
表 9 WI-FI 射频基本参数.....	5
表 10 输出功率.....	5
表 11 频率误差.....	6
表 12 EVM.....	6
表 13 接收灵敏度.....	6
表 14 板载 PCB 天线参数.....	7
表 15 典型炉温设置.....	11

## 图目录

图 1 硬件接口框图.....	1
-----------------	---

图 2 引脚分布.....	2
图 3 PCB 天线最小净空区 (单位: MM) .....	7
图 4 铜管天线尺寸 .....	7
图 5 外接天线连接器尺寸图 .....	8
图 6 总装尺寸图 (单位: MM, 误差 $\pm 0.1$ , 外尺寸误差 $\pm 0.3$ ) .....	9
图 7 推荐封装尺寸图 (单位: MM, 误差 $\pm 0.1$ ) .....	9
图 8 湿度卡.....	10
图 9 典型二次回流温度曲线 .....	11
图 10 标签示意图.....	12
图 11 存储条件示意图 .....	13

## 1. 模组简介

EMW301x 系列模组支持 HarmonyOS 操作系统，主要应用于物联网设备的华为 HiLink 平台接入。模组通过丰富的外设接口实现数据采集和设备控制，通过 Wi-Fi 网络连接，以 HiLink 协议连接到华为物联网平台。本系列模组通过各种不同的外形尺寸，接口形式，天线接口和温度范围，应用于各种设备的接入需求。

EMW3010 模组内置一个超高集成度的 Wi-Fi 控制器 Hi3861，提供了数据终端必备的计算能力和稳定的 Wi-Fi 连接性。该芯片集成了

- 288K 字节的 ROM
- 352K 字节的 SRAM
- 2M 字节的内嵌 Flash
- 符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准的 2.4GHz Wi-Fi 控制器

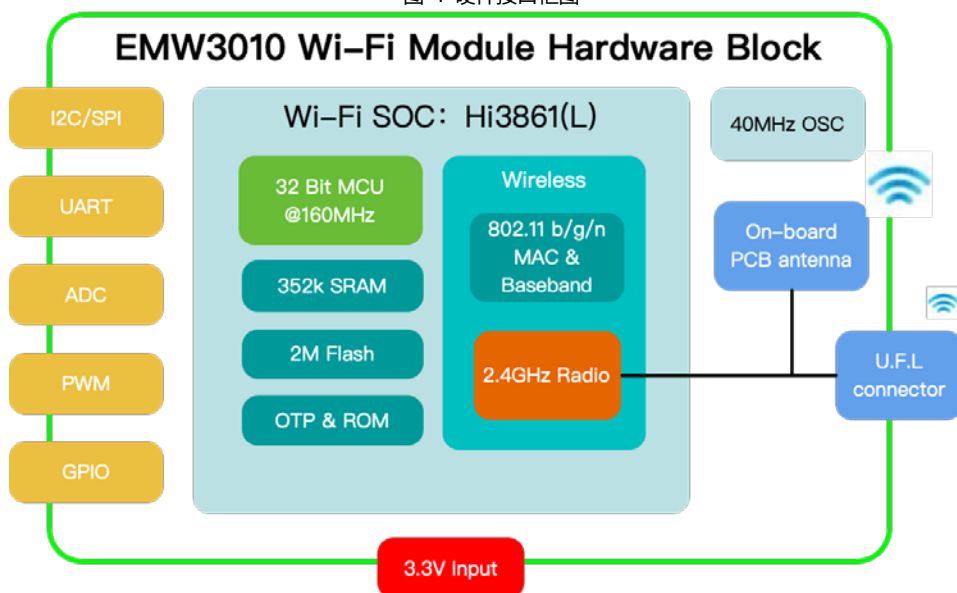
EMW3010 模组通过 3.3V 单电源供电，支持邮票孔安装方式，适用于各种智能家电应用场景。

上海庆科提供华为 LiteOS 操作系统和 HiLink SDK 支撑 EMW3010 系列模组的开发，提供高效的开发环境、丰富的示例程序和各种典型应用。

下图是 EMW3010 模组的硬件框图，主要包括：

- Wi-Fi 微控制器 Hi3861
- 板载或外接天线
- 电源和通讯接口

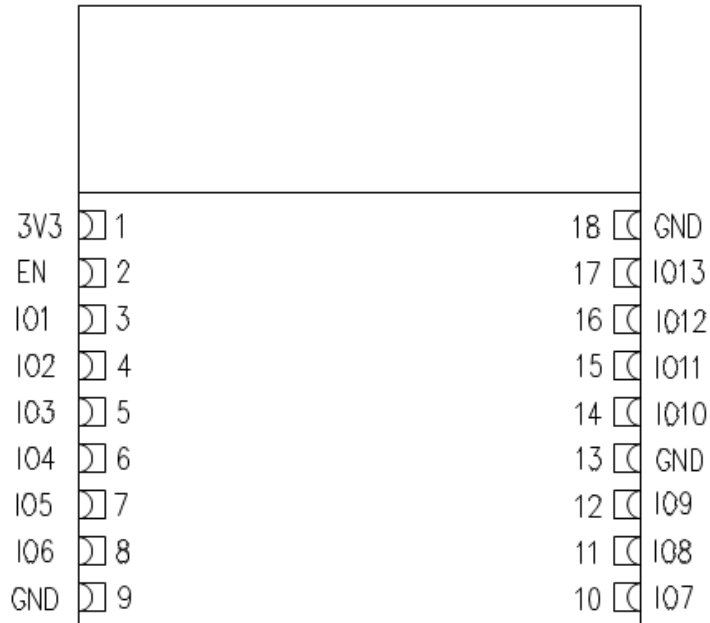
图 1 硬件接口框图



## 2. 引脚定义

### 2.1. 引脚分布

图 2 引脚分布



### 2.2. 引脚定义

表 1 引脚定义

Pin	Name	类型	Alternate Function							描述和建议功能	
			Default	1	2	3	4	5	6		7
1	VDD	P									2.3-3.6v 电源输入
2	PWRON	I									PMU 上电使能管脚。 0: 下电; 1: 上电。
3	IO1	I/O	UART1_CTS	GPIO_07	I2S0_CLK	PWM0	-	BT_ACTIVE	SPI0_RXD	ADC3	PMW0, WAKEUP
4	IO2	I/O	UART1_RTS	GPIO_08	I2S0_WS	PWM1	-	WLAN_ACTIVE	SPI0_TXD		PWM1
5	IO3	I/O	GPIO_10	UART2_CTS	SPI0_CLK	PWM1	I2C0_SDA	I2S0_TX	SDIO_D3	-	UART2_CTS
6	IO4	I/O	GPIO_09	UART2_RTS	SPI0_TXD	PWM0	I2C0_SCL	I2S0_MCK	SDIO_D2	ADC4	UART2_RTS
7	IO5	I/O	UART0_LOG_TXD	UART1_CTS	SPI1_CS1	PWM5	I2C1_SDA	-	GPIO_03	-	UART0_LOG_TXD
8	IO6	I/O	UART0_LOG_RXD	-	-	PWM1	I2C1_SCL	-	GPIO_04	ADC1	UART0_LOG_RXD
9	GND	G									GND
10	IO7	I/O	GPIO_13	UART2_RTS	UART0_LOG_TXD	PWM4	I2C0_SDA	I2S0_WS	SDIO_D0	ADC6	PWM4, WAKEUP
11	IO8	I/O	GPIO_12	UART2_RXD	SPI0_CS1	PWM3		I2S0_CLK	SDIO_CLK	ADC0	UART2_RXD
12	IO9	I/O	GPIO_11	UART2_TXD	SPI0_RXD	PWM2		I2S0_RX	SDIO_CMD	ADC5	UART2_TXD
13	GND	I/O									GND
14	IO10	I/O	GPIO_14	UART2_CTS	UART0_LOG_RXD	PWM5	I2C0_SCL	-	SDIO_D1	-	PWM5, WAKEUP
15	IO11	I/O	UART1_TXD	GPIO_06	I2S0_TX	PWM3	-	COEX_SWITCH	SPI0_CLK	-	PWM3
16	IO12	I/O	UART1_RXD	GPIO_05	I2S0_MCK	PWM2	-	BT_STATUS	SPI0_CS1	ADC2	PWM2, WAKEUP
17	IO13	I/O	GPIO_02	UART1_RTS	SPI1_TXD	PWM2	-	SSI_CLK	-	-	GPIO_02
18	GND	G									GND

**注意:**

1. 模组工作模式选择信号。在启动阶段，模组检测这些引脚的电平，并且进入特定的工作状态。电平和工作模

式的对应关系如表 2 所示:

表 2 工作模式选择

模组工作模式		IO13 (BOOT)	备注
Normal	BOOT	0	BOOT 模式
	APP	No Input(注意外部不要直接输入高电平)	正常启动

- (1). BOOT 和 APP 模式是由 MXCHIP 提供的固件判断的, 通过修改固件可以调整检测条件和功能。
- (2). 启动完成后, 处理器在运行 MXCHIP 提供的固件时, 固件检测 IO13 的状态来进入对应的工作模式。其中:
  - BOOT 模式中, 提供了一系列串口命令, 可以用于烧录应用程序。
  - APP 是运行应用程序的正常工作模式, 在 APP 启动时, 如果应用程序检测到从 UART2 (921600/8/n/1) 接收到连续的“#”字符, 则会进入 QC 检测模式, 从 UART2 输出特定的检测信息。
2. UART0 串口用于调试信息的输入/输出, 设计时不要使用, 并尽可能提供方便的方式引出, 以方便软件开发。
3. 不使用的引脚请保持悬空, 需要注意的是 IO 口在启动时是一种 floating 的状态。如果需要通过软件来配置引脚的状态, 需要等到 Bootloader 中的代码开始执行。从模组上电到 Bootloader 中的代码执行的时间会受到 flash 启动时间的影响。
4. 引脚 GPIO8, GPIO6 与 GPIO2 上电时不能输入高电平。
5. 模块内部对芯片引脚的处理如下:
  - PWRON: 100K 上拉电阻和 0.1uF 对地电容。
  - IO8, IO9: 680pF 的对地电容



## 3. 电气参数

### 3.1. 绝对最大参数

模块运行于绝对最大额定值以外,可能会造成永久性损坏。同时长时间暴露在最大额定值条件下会影响模块的可靠性。

表 3 绝对最大参数: 电压

Symbol	Ratings	Min	Max	Unit
$V_{DD}-V_{SS}$	Voltage	-0.3	3.6	V
$V_{IN}$	Input voltage on any other pin	$V_{SS}-0.3$	$V_{DD}+0.3$	V

### 3.2. 工作电压和电流

表 4 工作参数: 额定电压和电流

Symbol	Note	Specification			
		Min.	Typical	Max.	Unit
$V_{DD}$	Voltage	3.0	3.3	3.6	V
$I_{VDD}$	3.3V inrush current			400	mA
$I_{VDD}$	3.3V, RF Tx CCK 11M 21dBm, peak current			400	mA

### 3.3. 典型应用功耗

模组电流测试环境基于  $V_{DD}=3.3V$ , 普通办公应用环境下测试 (不同的测试环境下测得的数值会不同)。

表 5 典型应用功耗 (Hi3861H)

模式	Average	Max.	Unit	Note
Wi-Fi 关闭	21	TBD	mA	CPU Active
保持 Wi-Fi 连接	47.6	57.9	mA	关闭 Wi-Fi 和 MCU 低功耗
保持 Wi-Fi 连接	18.1	55.9	mA	开启 Wi-Fi 低功耗, 关闭 MCU 低功耗, DTIM=1
保持 Wi-Fi 连接	46	TBD	mA	开启 Wi-Fi 低功耗, 关闭 MCU 低功耗, DTIM=3
SoftAP 模式	54.1	114.2	mA	SoftAP 联网状态
Monitor 模式	52	TBD	mA	配网过程, 处于 RX 状态
Iperf 性能模式	TBD	TBD	mA	关闭 Wi-Fi 和 MCU 的低功耗, iperf 全速发送

表 6 典型应用功耗 (Hi3861L)

模式	Average	Max.	Unit	Note
Wi-Fi 关闭	21	TBD	mA	MCU 工作, WiFi 关闭
保持 Wi-Fi 连接	46	TBD	mA	Station 接口初始化
保持 Wi-Fi 连接	46	TBD	mA	Station 连接成功
保持 Wi-Fi 连接	400	TBD	$\mu A$	Station 连接成功, SLP=2, PS=1000 (DTIM=10)
保持 Wi-Fi 连接	3	TBD	mA	Station 连接成功, SLP=2, DTIM=1

### 3.4. 温度

表 7 温湿度参数

Symbol	Ratings	Max	Unit
T <sub>STG</sub>	Storage temperature	-55 to +125	°C
T <sub>work</sub>	Ambient Operating Temperature	-40 to +85	°C
T <sub>Jun</sub>	Junction Temperature	0 to +125	°C

### 3.5. 静电放电

表 8 静电释放参数

符号	名称	名称	等级	最大值	单位
V <sub>ESD</sub> (HBM)	静电释放电压 (人体模型)	TA= +25 °C 遵守 JESD22-A114	2	2000	V
V <sub>ESD</sub> (CDM)	静电释放电压 (放电设备模型)	TA = +25 °C 遵守 JESD22-C101	II	500	

### 3.6. 射频参数

#### 3.6.1. Wi-Fi 射频参数

表 9 Wi-Fi 射频基本参数

Item	Specification
Operating Frequency	2.412~2.484GHz
Channel BW	20MHz
Antenna Interface	1T1R, Single stream
Wi-Fi Standard	IEEE 802.11b/g/n
Modulation Type	11b: DBPSK, DQPSK, CCK for DSSS 11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM for OFDM 11n: MCS0~7, OFDM
Data Rates	802.11b: 1, 2, 5.5 and 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps 802.11n: MCS0~7, up to 72.2Mbps
Antenna type	One U.F.L connector for external antenna PCB printed ANT (Reserve)

#### 发射与接收性能

表 10 输出功率

TX Characteristics	Min.	Typical	Max.	Unit
Power@11Mbps, 802.11b	14	16	18	dBm
Power@54Mbps, 802.11g	14	16	18	dBm
Power@HT20, MCS7,802.11n	12	14	16	dBm

表 11 频率误差

TX Characteristics	Min.	Typical	Max.	Unit
Frequency Error	-10	-	+10	ppm

表 12 EVM

TX Characteristics	Min.	Typical	Max.	Unit
EVM@11Mbps, 802.11b	-	-20	-10	dB
EVM@54Mbps, 802.11g	-	-29	-25	dB
EVM@HT20, MCS7, 802.11n	-	-31	-27	dB

## 接收性能

表 13 接收灵敏度

RX Characteristics	Min.	Typical	Max.	Unit
<b>Minimum Input Level Sensitivity</b>				
PER <sub>≤</sub> 8%@11Mbps,802.11b	-	-88	-	dBm
PER <sub>≤</sub> 10%@54Mbps,802.11g	-	-75	-	dBm
PER <sub>≤</sub> 10%@HT20, MCS7, 802.11n	-	-71	-	dBm

## 4. 天线信息

EMW3010 有 PCB 天线和外接天线两种规格，请参照订货代码订货。使用 PCB 天线的模组上不焊接 IPX 天线连接器。通过 IPX 连接器连接外部天线，可以获得最佳的射频性能。

### 4.1. PCB 天线参数和使用

#### 4.1.1. 板载 PCB 天线参数

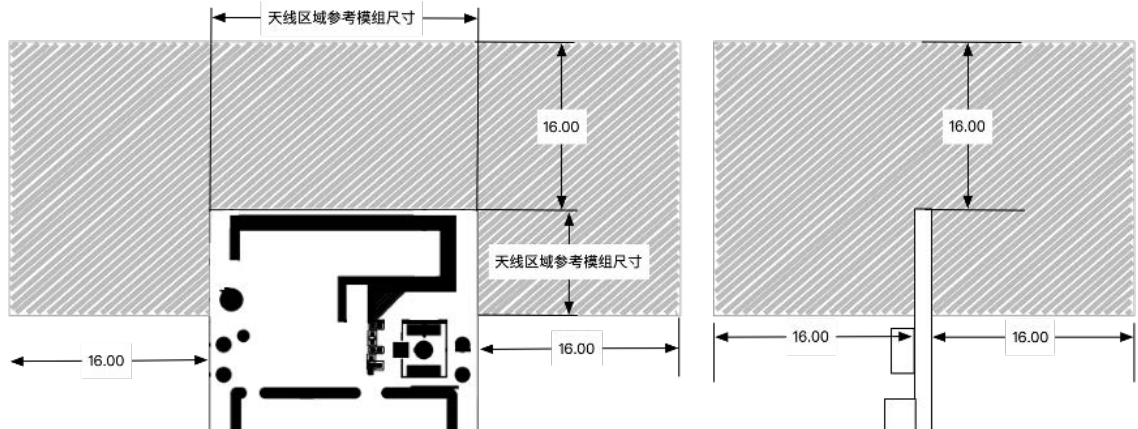
表 14 板载PCB天线参数

Item	Min.	Typical	Max.	Unit
Frequency	2400		2500	MHz
Impedance		50		$\Omega$
VSWR			2	
Gain	$\leq 2\text{dBi}$			
Efficiency	$>70\%$ or $>-1.54\text{dB}$			

#### 4.1.2. PCB 天线使用要点

使用模组上的 PCB 天线时，需要确保主板 PCB 和其它金属器件、连接器、PCB 过孔、走线、覆铜的距离至少 16mm 以上。下图中阴影部分标示区域需要远离金属器件、传感器、干扰源以及其它可能造成信号干扰的材料。

图 3 PCB天线最小净空区 (单位: mm)

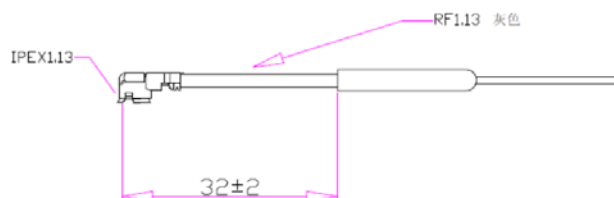


### 4.2. 外接天线参数和使用

用户可以根据应用环境选择不同外形尺寸，增益不大于 2dBi 的 2.4G 天线。

以下是 MXCHIP 常用的一款 IPEX 接头的铜管天线：

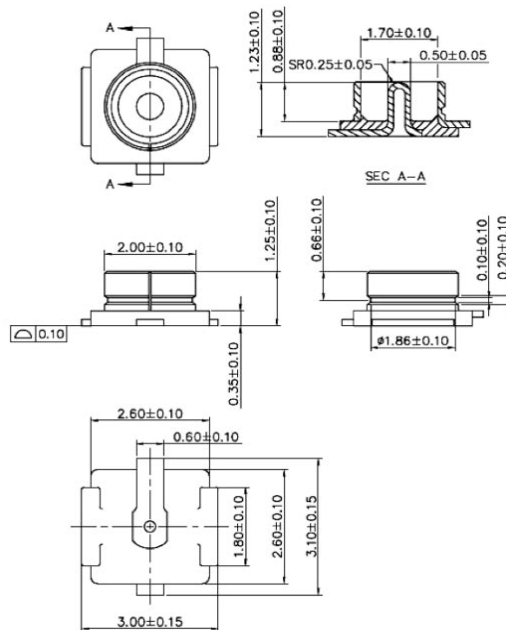
图 4 铜管天线尺寸



- 频率范围：2400-2500 MHz
- 输入阻抗：50 OHM
- 驻波比：< 2.0
- 增益 Gain：2.0DBI
- 极化：垂直
- 方向性：全向
- 铜管：4.4\*23mm
- 线材：1.13 灰色线 L-82mm

外接天线 IPEX 座尺寸：

图 5 外接天线连接器尺寸图



#### 4.2.1. SRRC 认证特别声明

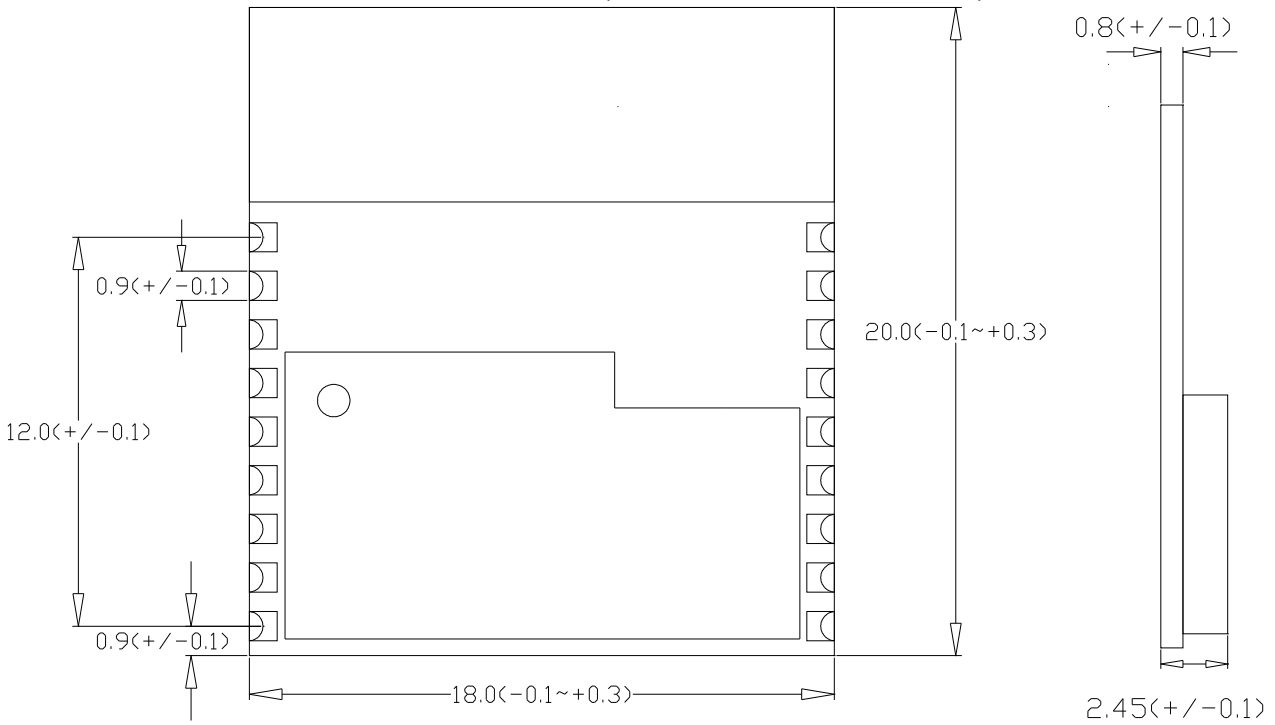
使用外接天线座的的模组型号获得的 SRRC 型号核准编号带 (M) 后缀，凡是带 (M) 后缀的模组特别声明如下：

**模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责。**

## 5. 总装尺寸和 PCB 封装

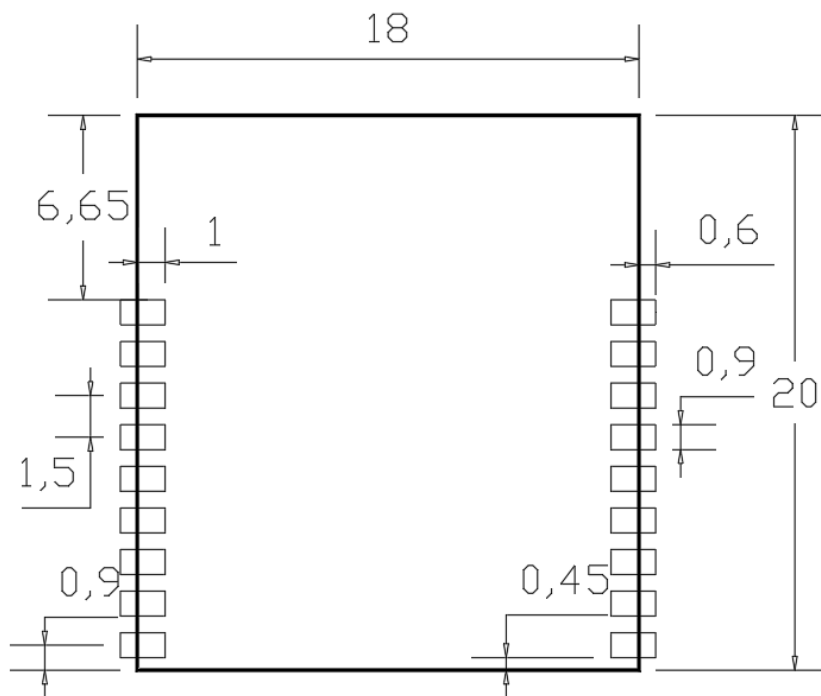
### 5.1. 总装尺寸图

图 6 总装尺寸图 (单位: mm, 误差±0.1, 外尺寸误差±0.3)



### 5.2. 推荐封装图

图 7 推荐封装尺寸图 (单位: mm, 误差±0.1)



## 6. 生产指南

庆科出厂的邮票口封装模块必须由 SMT 机器贴片，模块湿敏等级为 MSL3，拆封超过固定时间后贴片前要对模块进行烘烤。

- SMT 贴片需要仪器

- (1) 回流焊贴片机
- (2) AOI 检测仪
- (3) 口径 6-8mm 吸嘴

- 烘烤需要设备：

- (1) 柜式烘烤箱
- (2) 防静电、耐高温托盘
- (3) 防静电耐高温手套

庆科出厂的模块存储条件如下：

- 防潮袋必须储存在温度 < 30°C，湿度 < 85%RH 的环境中。
- 密封包装内装有湿度指示卡。

图 8 湿度卡



模块拆分后若湿度卡显示粉红色，则需要烘烤。

烘烤参数如下：

- 烘烤温度：120°C±5°C；烘烤时间：4 小时；
- 报警温度设定为 130°C；
- 自然条件下冷却 < 36°C 后，即可以进行 SMT 贴片；
- 干燥次数：1 次；
- 如果烘烤后超过 12 小时没有焊接，请再次进行烘烤。

如果拆封时间超过 3 个月，禁止使用 SMT 工艺焊接此批次模块，因为 PCB 沉金工艺，超过 3 个月焊盘氧化严重，SMT 贴片时极有可能导致虚焊、漏焊，由此带来的种种问题我司不承担相应责任；

SMT 贴片前请对模块进行 ESD（静电放电，静电释放）保护；

请根据回流焊曲线图进行 SMT 贴片，峰值温度 250°C。

为了确保回流焊合格率，首次贴片请抽取 10%产品进行目测、AOI 检测，以确保炉温控制、器件吸附方式、摆放方式的合理性；之后的批量生产建议每小时抽取 5-10 片进行目测、AOI 测试。

### 6.1. 注意事项

- 在生产全程中各工位的操作人员必须戴静电手套；
- 烘烤时不能超过烘烤时间；
- 烘烤时严禁加入爆炸性、可燃性、腐蚀性物质；
- 烘烤时，模块应用高温托盘放入烤箱中，保持每片模块之间空气流通，同时避免模块与烤箱内壁直接接触；
- 烘烤时请将烘烤箱门关好，保证烘烤箱封闭，防止温度外泄，影响烘烤效果；
- 烘烤箱运行时尽量不要打开箱门，若必须打开，尽量缩短可开门时间；
- 烘烤完毕后，需待模块自然冷却至<36°C后，方可戴静电手套拿出，以免烫伤；
- 操作时，严防模块底面沾水或者污物；

庆科出厂模块温湿度管控等级为 Level3,存储和烘烤条件依据 IPC/JEDEC J-STD-020。

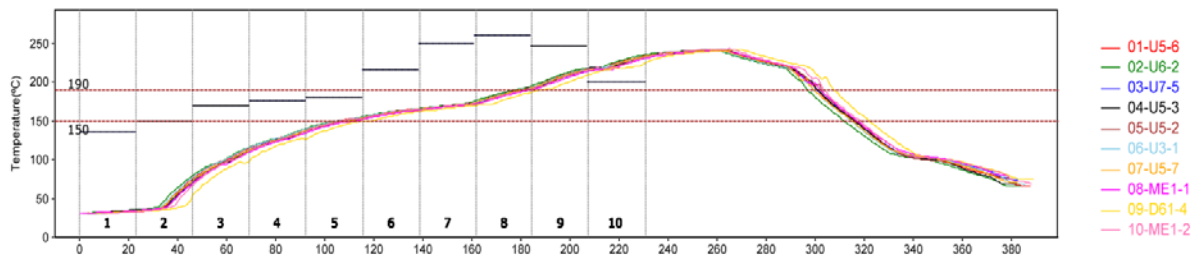
### 6.2. 二次回流温度曲线

建议使用焊锡膏型号：SAC305, 无铅。回流次数不超过 2 次。峰值温度不超过 245°C。以下是一个典型的炉温温度曲线设置。

表 15 典型炉温设置

焊炉设定	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10
上温区设定	135	150	170	175	180	215	250	260	247	200
下温区设定	135	150	170	175	180	215	250	260	247	200

图 9 典型二次回流温度曲线

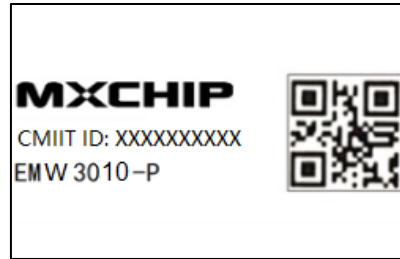


- 30°C ~ 150°C预热升温：0-3°C/s，典型值：1.2°C/s
- 150°C ~ 190°C浸温时间：60-100 秒，典型值：72 秒
- 峰值温度：245°C，典型值：242°C
- 220°C以上的时间：50 秒 ~ 90 秒，典型值：70 秒
- 217°C冷却速度：-3 ~ 0°C/s，典型值：-2.0°C/s



## 7. 标签信息

图 10 标签示意图




1. MXCHIP: 公司商标
2. EMW3010-P: 产品型号, P 表示使用板载 PCB 天线, E 表示使用外接天线
3. CMIIT ID: SRRC 型号授权 ID , 10 位
4. 二维码: 模组 MAC 地址

**备注: 由于生产批次和版本等原因, 以上标签示意图仅供参考, 请以实物为准。**

## 8. 存储条件

图 11 存储条件示意图



**CAUTION**  
This bag contains  
**MOISTURE-SENSITIVE DEVICES**

**LEVEL**  
**3**

If Blank, see adjacent bar code label

1. Calculated shelf life in sealed bag: 12 months at <math><40^{\circ}\text{C}</math> and <math><90\%</math> relative humidity (RH)
2. Peak package body temperature: \_\_\_\_\_  $260^{\circ}\text{C}$   
If Blank, see adjacent bar code label
3. After bag is opened, devices that will be subjected to reflow solder or other high temperature process must
  - a) Mounted within: \_\_\_\_\_ hrs. of factory conditions  
If Blank, see adjacent bar code label  
 $\leq 30^{\circ}\text{C}/60\% \text{RH}$ , OR
  - b) Stored at <math><10\% \text{RH}</math>
4. Devices require bake, before mounting, if:
  - a) Humidity Indicator Card is > 10% when read at  $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$
  - b) 3a or 3b not met.
5. If baking is required, devices may be baked for 48 hrs. at  $125 \pm 5^{\circ}\text{C}$

**Note:** If device containers cannot be subjected to high temperature or shorter bake times are desired, reference IPC/JEDEC J-STD-033 for bake procedure

Bag Seal Date: \_\_\_\_\_  
If Blank, see adjacent bar code label

**Note:** Level and body temperature defined by IPC/JEDEC J-STD-020

## 附录1. 销售与技术支持信息

如果需要咨询或购买本产品，请在办公时间拨打电话咨询上海庆科信息技术有限公司。

办公时间：

星期一至星期五上午：9:00~12:00，下午：13:00~18:00

联系电话：+86-21-52655026

联系地址：上海市普陀区金沙江路 2145 弄 5 号 9 楼

邮编：200333

Email: [sales@mxchip.com](mailto:sales@mxchip.com)